



Depuis 1972, l'américain Aries Electronics basé en Pennsylvanie conçoit et fabrique des solutions d'interconnexions spécialisées. Aries Electronics est aujourd'hui le leader des Support de Test (DIP, PGA, PLCC, et SOIC) et des adaptateurs et grâce à sa ligne de Correct-A-Chip® des connecteurs « intelligents ».

Présent chez les plus grands industriels du monde, la gamme produits d'Aries Electronics se décompose en supports ZIF (Zero Insertion Force), supports de test RF, supports de burn-in, support pour équipements de test automatique et des adaptateurs.

Partenaire d'ISC-Distrel depuis plus de 20 ans, Aries Electronics est un fabricant talentueux et innovateur !

Avec des délais de fabrication courts et un excellent rapport qualité / prix, les produits d'Aries Electronics sont adaptés aux besoins des clients.

Les produits sont les suivants :

- **Supports ZIF (Zero Insertion Force)** : nombreuses configurations (nombre de broches, espacement des rangées et empreintes du composant à tester). Ils peuvent être soudés sur un circuit imprimé, un autre support ou sur un réceptacle de test. Les leviers de manœuvres de ces supports DIP peuvent être à gauche, à droite, en haut ou en bas du support. Ces supports sont disponibles en boîtier DIP, SOIC, PGA et PLCC et peuvent être fabriqués sur cahier des charges clients.
- **Supports ZIF DIL à haute température** : 200 à 250°C (300°C en option), 24 à 48 contacts au pas de 2.54 mm, avec un espacement entre rangée de 7.62 à 15.24mm.
- **Supports ZIF PGA à haute température** : de -65 à 125°C (voire 200°C en option) au pas de 2.54 mm, disponibles en grilles standards 8x8 à 21x21 contacts. Ces supports ZIF haute température sont utilisables de par leur bande passante à hautes fréquences (-1 dB à > 40GHz) et leurs faibles inductances (0.02 nH) pour réaliser des tests automatiques et de burn-in fiables.

Ces supports sont disponibles en boîtier CSP, QFN, MLCC, DFN, BCC, QFN, QFP, MLF, DFN, SSOP, TSSOP, TSO, SOP, SOIC, LGA, LCC, PLCC et pour tous types d'empreintes CMS.

- **Supports de test RF et de Burn In** : utilisent des contacts brevetés qui permettent de tester la fonctionnalité d'un composant avec jusqu'à une fréquence de 90 GHz pour des pas de 0.2mm.
Ces supports moulés sont disponibles en cinq tailles de composants à tester jusqu'à une taille de 55x55mm. Les broches sont usinées pour tout type de composants. Ces supports sont disponibles en boîtier CSP, QFN, MLCC, DFN, BCC, QFN, QFP, MLF, DFN, SSOP, TSSOP, TSO, SOP, SOIC, LGA, LCC, PLCC et pour tous types d'empreintes CMS.
- **Adaptateurs Correct-A-Chip** : utilisés pour les traitements d'obsolescences de composants par changement d'empreinte pour types d'empreintes , traversant vers CMS, CMS vers CMS, CMS vers traversant et non RoHS vers RoHS.
- **Verti-sockets** : support DIL à montage vertical ou horizontal pour afficheurs (LED, 7 segments, LCD, ...), avec contacts tulipe ou double lyre, dans de nombreuses configurations de montage et d'empreintes.
- **Supports DIL haut profil** : pour surélever le composant utilisé d'une hauteur de 6,6mm à 31,75 mm, avec contacts tulipe ou double lyre, pins à wrapper à souder sur PCB, en simple ou double rangée, et ouverts au centre pour un meilleur flux d'air.
- Sont également proposés des câbles en nappes, nus, assemblés avec un ou des connecteurs type DIL, type SIL en version droite et/ou coudée.
Aries Electronics propose également la réalisation et fabrication de produits développés sur cahier des charges clients et adaptés pour l'application concernée.

Les produits de Aries Electronics sont utilisés dans les applications ou marchés suivants : test de composants, médical, industriel, robotique et militaire. Aries Electronics a obtenu la qualification ISO 9001 :2015.